

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231122

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	2023年11月20日~2023年11月22日：易同投资：夏济舟；晓煜投资：王星宇；大成基金：吴志强、王帅；淳瀚投资：闻豪；长江电子：王泽罡；创富兆业：马国庆；固禾投资：纪双陆；星石投资：徐星宇；天风证券：吴雨；华福证券：卢宇程、杨钟、魏征宇；理成资产：吴圣涛；兴全基金：任相栋；广发基金：曾刚；交银施罗德基金：刘鹏；高毅资产：邓晓峰；太保资产：陈永亮；达成基金：胡经天；海通证券：肖隽翀、张幸；璞来资产：魏来；华鑫电子：吕卓阳、何鹏程；交银基金：余李平；中银国际：余媛媛；东方资管：蔡志鹏；宏利基金：刘少卿等 29 名投资者及证券人员
时间	2023年11月20日~2023年11月22日
地点	公司9楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨平彩女士、投资者关系经理朱梦茜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 CMP 抛光垫业务第四季度预期如何？ 答：2023 年前三季度，公司 CMP 抛光垫产品累计实现产品销售收入 2.68 亿元，其中第三季度实现产品销售收入 1.19 亿元，环比第二季度增长 41%，且已恢复至去年平均水平。公司力争在第四季度继续保持 CMP 抛光垫业务逐步恢复、持续发展的态势，实现环比增长。</p> <p>问 2：公司潜江 CMP 抛光软垫业务推进情况如何？ 答：公司潜江 CMP 软垫工厂是全球首家型号全布局的软抛光垫工厂，拥有高度自动化水平生产线，具备为客户定制开发特定需求抛光垫产品的能力，主要产品类型包括半导体用精抛垫及大硅片用抛光垫。在半导体用精抛垫方面，公司已量产各种类型软抛光垫，全面覆盖 Cu barrier（铜阻挡层）、W buff（钨制程精抛）、Oxbuff（氧化硅制程精抛）、Grinding（晶背研磨）</p>

等制程，部分产品在客户端批量使用，其余客户测试反馈积极，大部分进入到产品测试阶段，预计明年实现产销量的快速增长。在大硅片用抛光垫方面，小尺寸产品在客户端取得正面反馈，部分客户已经推进到产品测试阶段，年底前有望取得订单；大尺寸产品持续打造上游材料和设备供应链，预计将于明年上半年实现量产。公司潜江 CMP 软垫工厂进一步完善了公司 CMP 抛光垫业务全品类产品布局，对公司 CMP 抛光垫业务的市场拓展起到了积极作用。

问 3：公司 CMP 抛光液业务推进情况怎样？

答：公司现已布局全制程 CMP 抛光液产品，型号基本全面覆盖下游晶圆厂客户使用需求，且具备送样、批量销售能力。目前，公司已有介电材料抛光液、以自产氧化铝研磨粒子为基础的金属抛光液、钨抛光液、大硅片抛光液、多晶硅制程等多款抛光液产品在客户端销售，其余制程 CMP 抛光液产品在客户端持续验证中，部分型号有望在第四季度成功导入。此外，鼎龙（仙桃）半导体材料产业园扩产项目：年产 1 万吨 CMP 抛光液一期及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子已于 11 月全面竣工，年内开始试生产供应，为 CMP 抛光液产品后续配合市场需求加速放量奠定基础。

问 4：公司半导体显示材料在下游客户的导入和采购情况如何？

答：在半导体显示材料板块，公司围绕柔性 OLED 显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料：黄色聚酰亚胺浆料 YPI、半导体 OLED 面板光刻胶（光敏聚酰亚胺）PSPI 等产品进行布局。其中 YPI 产品于 2021 年开始在下游国内主流面板客户端开始批量放量，PSPI 产品于 2022 年下半年开始在客户端实现批量销售，目前公司已成为国内部分主流面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商，确立 YPI、PSPI 产品国产供应领先地位。

问 5：公司半导体显示材料业务后续持续增长的驱动因素有哪些？

答：公司布局的 YPI、PSPI、INK 材料均为柔性 OLED 显示屏幕制造用的关键材料。伴随着 OLED 面板在终端应用的渗透占比持续提升、OLED 面板产业往国内转移，国内终端 AMOLED 面板市场规模的持续增长，预计未来 3-5 年国内 OLED 产能进入快速释放期，将拉动新型显示产业供应链上游材料的需求，这对公司 YPI、PSPI 等产品持续放量有促进作用。此外，公司也会持续进行在下游面板客户端的市场开拓工作，努力提升公司 YPI、PSPI 产品在国内市场的市占率水平，争取保持公司半导体显示材料业务的销量加速提升态势。

问 6：公司预计仙桃产业园扩产项目的放量节奏如何？

答：鼎龙（仙桃）半导体材料产业园扩产项目：年产 1000 吨半导体 OLED 面板光刻胶（PSPI）、年产 1 万吨 CMP 抛光液一期及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子项目已于今年 11 月全面竣工，年内开始试生产供应。目前公司半导体 OLED 面板光刻胶 PSPI 产品处于快速放量阶段，已成为部分国内主流面板客户的第一供应商，在其他面板客户的市场拓展和导入上量也在持续进行；CMP 抛光液方面，公司已有多款产品在客户端持续批量销售，其余型号产品在客户端持续验证、导入。随着明年公司 PSPI、CMP

抛光液产品销售进一步增长，鼎龙（仙桃）半导体材料产业园将配合市场订单增长节奏，为上述业务快速发展提供有力的产能支持。

问 7：公司布局的半导体封装用 PI 与现有业务有哪些技术关联？

答：半导体封装 PI 业务与公司已有半导体面板显示材料 YPI、PSPI 业务高度相关。公司目前全面布局半导体封装 PI，产品覆盖非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶和负性 PSPI 光刻胶，其中：非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶的开发充分借鉴吸收了公司半导体面板显示材料 YPI、PSPI 的研发和产业化经验，属于公司现有技术在不同应用领域的延伸拓展；负性 PSPI 光刻胶的开发同样借鉴了公司的 PI 树脂合成和产业化技术以及半导体 OLED 面板光刻胶 PSPI 的配方开发技术。在公司有机合成和高分子合成两大核心技术平台，聚酰亚胺和光刻胶两大产品平台的加持下，公司的半导体封装 PI 项目争取按预期计划快速推进。

问 8：公司在产品开发方面展现出较强的技术迁移的能力，原因是什么？

答：公司作为国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，二十多年来在创新材料端持续深耕突破，拥有丰富的产品开发和产业化经验。其中：公司坚持材料技术创新与人才团队培养同步，拥有高效的“老带新”成长环境、完善的人才培养机制和专业化的研发平台，并已建立稳定的核心技术人才团队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专业人才团队。同时，公司重视技术整合和技术平台，二十多年来利用自身人才团队的稳定、技术的积累和行业的经验打造七大技术平台，技术平台将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中，如高分子合成技术平台先后为公司彩色聚合碳粉、CMP 抛光垫、半导体显示材料 YPI、PSPI、半导体先进封装材料等产品提供了技术支持，有机合成技术平台先后为电荷调节剂、光敏聚酰亚胺 PSPI 单体、面板封装材料 TFE-INK 单体、半导体先进封装材料临时键合胶及封装光刻胶单体等提供了技术支持。整体来看，公司稳定、经验丰富的技术团队和成熟的技术平台等深厚技术储备能帮助公司达到已有技术迁移运用到新项目开发中的效果，有助于提高新项目开发的速度和成功率。

问 9：公司在打印复印通用耗材业务方面的经营发展情况如何？

答：公司在保障传统业务—打印复印通用耗材业务的整体竞争力和业绩贡献的同时，持续推进打印耗材业务的效率提升和转型升级。其中：上游彩色碳粉、耗材芯片产品继续保持对终端硒鼓、墨盒成品的业务协同、支持力度，同时芯片业务从打印复印耗材芯片向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行深度转型，目前大部分主要处于研发和测试阶段，小部分进行到 MPW（多项目晶圆）测试和样品调试阶段。终端硒鼓业务通过内部整合、划转，进一步提高硒鼓业务管理及运营效率，降低管理成本。终端墨盒业务子公司绩迅科技在新三板挂牌，同时积极拓展线上客户及市场渠道，进一步提升公司墨盒业务的核心竞争力。

附件清单	无
日期	2023 年 11 月 22 日